

证券代码：688257

证券简称：新锐股份

## 苏州新锐合金工具股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	国元基金、鞍资(天津)股权投资基金、鞍钢集团、常州投资集团、川江投资、赣州发展投资基金、广东恒阔投资、广州开投智造产业投资、广州开发区投资集团、穗开投资、凯得投资、国海创新资本、国泰租赁、河北国控资本、河北省国企改革发展基金、黑龙江省新产业投资、湖南迪策投资、华菱津杉(天津)产业投资、湖南轻盐创业投资、华宝（上海）股权投资基金、江苏高投、江苏苏豪投资、江苏永钢集团、金城投资、京呈资本、江西大成资本、江西江投资本、江西金投基金、江西省金控资本、江西水投资本、江西铜业（北京）国际投资、南昌产投投资基金、南方天辰（北京）投资、前海中船（深圳）私募股权基金、青岛财通创业投资、青岛市创新投资、青岛市北建设投资、泉州市国投资产、厦门国贸集团、厦门信息集团、山东能源集团、上海鼎赣投资、南昌市政投资集团、绍兴市国鼎私募基金、绍兴国控、四川璞信产融投资、四川振兴嘉杰私募证券投资基金、成都丝路重组股权投资基金、苏州高新私募基金、苏州高新投资、苏州狮山创新投资、台州市创收股权投资、台州市资产管理、无锡国联新创私募投资基金、芜湖江瑞投资、武汉市蔡甸产业发展基金、信达资本、长沙高新技术创业投资、长沙高新炜德基金、浙江农发产业投资、浙江省发展资产经营、镇江银河创业投资、中国银河投资、中电科投资、诺德基金、平安基金、易米基金、国华人寿、国华兴益、中汇人寿、中英人寿、财信吉祥人寿、财通证券、财信证券、第一创业证券、东兴证券、光大富尊投资、国信证券、国元证券、华安证券、华西银峰投资、

江海证券、西南证券、英大证券、博润银泰、洪泰同创、北京汇信恒宝投资、北京杰隆达投资、北京珏岩投资、北京泰德圣私募基金、兴宝基金、兴宝国际信托、北京衍恒投资、厚沚投资（海南）、北京中财龙马资本投资、成都立华投资、德润鹏远高新投资(广州)、福建银丰创业投资、广东臻远私募基金、海南文泰日晟私募股权投资基金、淮海天玺投资、江苏银创资本、锦绣中和（天津）投资、量函（上海）私募基金、宁波梅山保税港区沚途投资、青岛华盛私募基金、青岛英轩投资、山东益兴创业投资、上海复星创富投资、上海海越私募基金、上海弘尚资产、上海嘉融投资、上海君怀投资、吴建昕、中铖润智资产管理、张奇智、上海乐苍投资、上海林拙投资、上海同安投资、上海毅远基金、上海永达资产管理、上海兆顺私募基金、深圳君宜私募证券基金、深圳纽富斯投资、深圳市华宝万盈资产、矢量私募基金、苏州明善投资、伟星资产管理、西安博成基金、浙江广杰投资、杭州瀚昭企业管理咨询、浙江谦履私募基金、浙江永禧投资、中非信银投资、中欧基金、中信私募基金、重庆华西宏赐股权投资基金、宁波电子信息集团、上海德汇集团、上海铭大实业(集团)、深圳市中金岭南期货、五矿信托、林金涛、田万彪、尹岩龙、烟台佳杰投资、烟建集团、深圳旦恩先锋投资、天风证券（自营）、中银国际证券、测度投资、Beijing FY Private Fund、上海古曲私募基金、中信期货、太平洋保险资产管理、上海水璞私募基金、光大证券、深圳亘泰投资、华创证券、3WFundManagementLtd.、东北证券（自营）、深圳正圆投资、上海浦泓投资、华夏东方养老资产管理、兴业证券（自营）、福建豪山资产、创金合信管理、农银汇理基金、巨杉资产、Willing Capital Management、凯丰投资、广州市航长投资、阳光资产、招商证券、国任保险、华夏基金、朱雀基金、深圳市河床资产管理、上海歌汝私募基金、大家资产管理、世嘉控股集团、北京和聚投资、永赢基金、国泰基金、深圳望正资产管理、金之灏基金、首创证券（自营）、睿亿投资、广银理财、国金基金、潼骁基金、中银基金、博远基金、新华

	<p>基金、中略投资、中信证券、景顺、中金机械、招商基金、广东恒阔。</p> <p>在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。</p>
时间	<p>2026年5月7日 20:00-21:30</p> <p>2026年5月11日 15:00-16:30</p> <p>2026年5月14日 9:30-10:30</p>
地点	公司会议室（电话会议）
公司接待人员	<p>董事、联席 CEO、财务总监：刘国柱</p> <p>董事、副总裁、董事会秘书：袁艾</p> <p>董事长助理兼投关总监：鲍榕铭</p> <p>证券事务代表：魏瑞瑶</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司国际化战略的核心考虑及未来规划？</p> <p>公司长期坚持国际化与品牌化发展战略，未来将持续深耕海外市场，依托海外并购与本地化运营，稳步提升全球市场覆盖与品牌影响力。</p> <p>2、公司境内外收入占比发生变化的原因是什么？</p> <p>受国内硬质合金业务、刀具业务快速增长影响且其主要业务在国内，短期内境外收入占比略有下降，国内业务毛利率水平良好，整体盈利质量未受影响，收入结构略有变化符合公司当前发展阶段。</p> <p>3、公司在硬质合金行业的竞争优势主要体现在哪些方面？</p> <p>公司聚焦中高端硬质合金市场，在凿岩工具合金、微小径棒材、滚刀材料等细分领域具备国内领先优势，同时构建“材料+工具”垂直一体化布局，形成差异化核心竞争力。</p> <p>4、上游钨原料供应是否稳定，如何应对价格波动风险？</p> <p>钨原料市场供应格局相对分散，公司长期保持稳定的供应渠道，不存在供应瓶颈风险。针对原材料价格波动，公司通过合理把握采购时点、预付款锁量等方式管控成本，执行审慎库存策略。</p> <p>5、公司并购整合模式及已实施项目的整合效果如何？</p>

公司采用“资本经营+产业并购”双轮驱动模式，对并购标的实行董事会治理下的授权经营，保障治理规范与经营活力，已完成的海内外并购项目在业务协同、技术互补、业绩增长等方面均取得良好成效。

6、公司 2025 年度及 2026 年一季度业绩增长的主要原因？

主要原因是市场需求稳步增长，公司聚焦硬质合金与工具核心主业，持续完善全球布局，强化技术创新与产品结构升级，稳步推进并购整合，带动凿岩、切削等核心产品销量稳步提升。同时，在原材料涨价背景下，公司对全系产品实施全面调价。

7、公司再融资募投项目的建设背景及产能消化安排？

本次募投项目围绕数控刀片、凿岩工具、总部刀具研发中心布局，均基于现有业务满产、市场需求旺盛、订单支撑充分的前提下推进。公司将依托成熟客户资源与销售渠道，保障新增产能合理消化。

8、公司 PCB 钻针业务相关并购项目最新进展如何？

公司收购慧联电子 PCB 板块业务的项目按计划推进，当前慧联电子非 PCB 业务剥离工作有序开展，现已推进至债务剥离公示阶段，后续将依托技术积累与产能扩张，把握 AI 算力基建带动的 PCB 钻针市场机遇，打造业绩增长点。

9、公司不同业务板块的销售模式如何区分，经销与直销如何搭配？

公司根据产品特性与客户类型采用差异化销售模式，硬质合金、凿岩工具、非标整硬刀具、油服业务以直销为主，数控刀片等产品以经销为主。

10、公司对并购标的在团队与机制方面采取哪些整合措施？

公司在保持标的日常经营稳定的基础上，不断推进管理团队专业化，优化中层架构与薪酬激励体系，建立市场化考核与增量分享机制，同步完善内控与治理规范，提升经营活力。

11、公司当前核心业务产能状况如何，募投项目建设节奏如何安

排？

公司主要产品产能利用率处于较高水平，部分产品存在产能紧张，而需要外购或者代工的情况。本次再融资募投项目将按规划稳步推进，缓解产能瓶颈、支撑高端产品放量。

12、公司在高端刀具领域的技术布局与国产替代推进情况如何？

公司聚焦数控刀片、整硬刀具、金属陶瓷刀具等高端领域，并将通过收购慧联电子切入 PCB 刀具领域，公司持续加大刀具领域的研发投入，依托自主研发与并购协同补齐技术短板，在多个细分刀具领域实现技术突破，稳步推进进口替代。

13、公司对未来业务规模与长期发展方向有哪些规划？

公司坚持全产业链、全球化发展战略，以“内生增长+外延并购”双轮驱动，聚焦硬质合金、凿岩工具、切削工具等核心板块，不断优化产品结构与市场布局，推动业务规模与综合竞争力持续提升。

14、公司数控刀片业务实现高速增长的核心原因及当前产能情况如何？

公司数控刀片聚焦中高端进口替代，定位对标日韩欧美品牌，叠加基数较低，近年持续保持高速增长。目前现有产能满负荷生产，新产能建设按计划推进，以支撑后续订单交付。

15、慧联电子 PCB 钻针业务在高端产品与长径比技术上的布局与进展如何？

慧联电子重点布局 AI PCB 所需的高长径比等钻针。其中，普通 PCB 钻针方面，重点布局 0.1\*2.0mm、0.15\*6.0mm、0.2\*6.0mm、0.2\*8.0mm、0.2\*10.0mm 等型号 PCB 钻针，其中部分型号已经批量供货；金刚石涂层 PCB 钻针方面：目前 0.25\*7.5mm、0.20\*10mm 等型号正在验证，技术与产品结构持续向高端升级。

慧联电子是全球市场极少数同时拥有烧结炉、无心磨床、粗精磨一体机、开槽磨床、涂层设备等 PCB 钻针加工设备自制能力的厂商。

16、慧联电子核心团队与设备自制能力，将如何为公司整体产业

	<p>链赋能？</p> <p>答：慧联电子具备 PCB 关键设备自主研发制造能力，其资深装备团队已与公司开展联合开发，未来可在硬质合金烧结、刀具涂层、精密磨床等环节实现技术共享与设备赋能，提升全产业链自制率与成本优势。</p> <p>17、目前公司钴针棒材的研发情况如何？</p> <p>公司高度重视 PCB 钴针棒材的技术研发与产能布局，已在武汉生产基地建成专用产线并实现批量供货。当前可稳定供应 1.0mm、2.2mm 等主流规格 PCB 钴针棒材，产品聚焦适配 AI 算力 PCB 高长径比、高稳定性需求。公司依托挤压成型、微孔精密加工、材料均匀性控制等核心技术，重点解决微小径钴针易断针、寿命稳定性等行业痛点，持续推进 0.2mm 及以下超细径、50 倍高长径比产品的验证与迭代，材料性能与一致性达到国内先进水平，可有效满足下游高端 PCB 钴针生产需求。</p>
日期	2026 年 5 月 7 日-2026 年 5 月 14 日